



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110124004C
2011 年 9 月 27 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL-SLL LBC3S プロセス 一部製品 前処理サイト追加のご案内
(認定済 178 製品への追加認定 1 製品の連絡)

(第二版 PCN20110124004A 2011 年 6 月 23 日, 初版 PCN20110124004 2011 年 2 月 1 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> -		
変更内容	下記変更について認定済 178 製品への追加認定 1 製品の連絡になります。 HVAL-SLL LBC3S プロセス 一部製品 前処理サイト追加 現行 : TI-Sherman (米国) 変更後 : TI-Sherman (米国), TI-Hi ji (日本)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は 11 月上旬の出荷より予定しています。 認定終了品は 8 月上旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容 : 今回のお知らせは、下記変更について認定済178製品への追加認定1製品の連絡になります。弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) LBC3S プロセス 一部製品の 前処理サイトについて、現行 TI-Sherman (米国) サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Hi ji (日本) サイトを追加し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
前処理サイト	TI-Sherman (米国)	TI-Sherman (米国) TI-Hi ji (日本)

理由 : 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名

■:追加認定品 □:認定終了品

CD3301RHHR	MAX232NSRE4	MAX3232IDW	MAX3243IDWG4	TRS3232CDRG4
HPA00699CDBR	MAX232NSRG4	MAX3232IDWE4	MAX3243IDWR	TRS3232CDWR
MAX232D	MAX3232CD	MAX3232IDWG4	MAX3243IDWRE4	TRS3232CDWRG4
MAX232DE4	MAX3232CDB	MAX3232IDWR	MAX3243IDWRG4	TRS3232CPW
MAX232DG4	MAX3232CDBE4	MAX3232IDWRE4	MAX3243IPW	TRS3232CPWG4
MAX232DR	MAX3232CDBG4	MAX3232IDWRG4	MAX3243IPWG4	TRS3232IDR
MAX232DRE4	MAX3232CDBR	MAX3232IPW	MAX3243IPWR	TRS3232IDRG4
MAX232DRG4	MAX3232CDBRE4	MAX3232IPWE4	MAX3243IPWRE4	TRS3232IPW
MAX232DW	MAX3232CDBRG4	MAX3232IPWG4	MAX3243IPWRG4	TRS3232IPWG4
MAX232DW-C	MAX3232CDE4	MAX3232IPWR	TRS232D	TRS3232IPWR
MAX232DWE4	MAX3232CDG4	MAX3232IPWRE4	TRS232DG4	TRS3232IPWRG4
MAX232DWG4	MAX3232CDR	MAX3232IPWRG4	TRS232DR	TRS3243CDB
MAX232DWR	MAX3232CDRE4	MAX3243CDB	TRS232DRG4	TRS3243CDBG4
MAX232DWR-C	MAX3232CDRG4	MAX3243CDBE4	TRS232DW	TRS3243CDBR
MAX232DWRE4	MAX3232CDW	MAX3243CDBG4	TRS232DWG4	TRS3243CDBRG4
MAX232DWRG4	MAX3232CDWG4	MAX3243CDBR	TRS232DWR	TRS3243CDW
MAX232ID	MAX3232CDWR	MAX3243CDBRE4	TRS232DWRG4	TRS3243CDWG4
MAX232IDE4	MAX3232CDWRG4	MAX3243CDBRG4	TRS232ID	TRS3243CDWR
MAX232IDG4	MAX3232CPW	MAX3243CDW	TRS232IDG4	TRS3243CDWRG4
MAX232IDR	MAX3232CPWE4	MAX3243CDWE4	TRS232IDR	TRS3243CPW
MAX232IDRE4	MAX3232CPWG4	MAX3243CDWG4	TRS232IDRG4	TRS3243CPWG4
MAX232IDRG4	MAX3232CPWR	MAX3243CDWR	TRS232IDW	TRS3243CPWR
MAX232IDW	MAX3232CPWRE4	MAX3243CDWRG4	TRS232IDWG4	TRS3243CPWRG4
MAX232IDWE4	MAX3232CPWRG4	MAX3243CPW	TRS232IDWR	TRS3243IDB
MAX232IDWG4	MAX3232ID	MAX3243CPWE4	TRS232IDWRG4	TRS3243IDBG4
MAX232IDWR	MAX3232IDB	MAX3243CPWG4	TRS232IN	TRS3243IDBR
MAX232IDWRE4	MAX3232IDBE4	MAX3243CPWR	TRS232INE4	TRS3243IDBRG4
MAX232IDWRG4	MAX3232IDBG4	MAX3243CPWRE4	TRS232N	TRS3243IDW
MAX232IN	MAX3232IDBR	MAX3243CPWRG4	TRS232NE4	TRS3243IDWG4
MAX232INE4	MAX3232IDBRE4	MAX3243IDB	TRS232NS	TRS3243IDWR
MAX232N	MAX3232IDBRG4	MAX3243IDBE4	TRS232NSG4	TRS3243IDWRG4
MAX232NE4	MAX3232IDE4	MAX3243IDBG4	TRS232NSR	TRS3243IPW
MAX232NS	MAX3232IDG4	MAX3243IDBR	TRS232NSRG4	TRS3243IPWG4
MAX232NSE4	MAX3232IDR	MAX3243IDBRE4	TRS3232CDBR	TRS3243IPWR
MAX232NSG4	MAX3232IDRE4	MAX3243IDBRG4	TRS3232CDBRG4	TRS3243IPWRG4
MAX232NSR	MAX3232IDRG4	MAX3243IDW	TRS3232CDR	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載のサイト記号(ラベルの"20L/21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記の様になります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TI-Sherman	TI-Hiji
CSO (20L): 前処理サイトコード	SHE	HIJ
CCO (21L): 生産国記号	USA	JPN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年9月12日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	CD3301RHHR	-	-		
Wafer Fab Site:	HIJ	Wafer Fab Process:	LBC3S		
Wafer diameter(mm):	150	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW		
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-		
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77/0	77/0	77/0	
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved	
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0	
**Life Test	150C, 300 Hrs	77/0	77/0	77/0	
ESD CDM	Per JEDEC	3/0	3/0	3/0	
ESD HBM	Per JEDEC	3/0	3/0	3/0	
Latch-up	per JESD78	6/0	6/0	6/0	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	
Note: ** Preconditioning sequence, JEDEC L-3/260C					

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年6月14日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	MAX232N	-	-		
Wafer Fab Site:	HIJ	Wafer Fab Process:	LBC3S		
Wafer diameter(mm):	150	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW		
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77/0	-	-	
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	-	-	
T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	-	-	
ESD CDM	Per JEDEC	3/0	-	-	
ESD HBM	Per JEDEC	3/0	-	-	
Latch-up	per JESD78	6/0	-	-	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年6月14日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	MAX3232CDB	-	-	
Wafer Fab Site:	HIJ	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer diameter(mm):	150	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77/0	-	-
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	-	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	-	-
ESD CDM	Per JEDEC	3/0	-	-
ESD HBM	Per JEDEC	3/0	-	-
Latch-up	per JESD78	6/0	-	-
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年6月14日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	MAX3243CDBR	-	-	
Wafer Fab Site:	HIJ	Wafer Fab Process:	LBC3S	
Wafer diameter(mm):	150	Metallization:	7600A Al-Cu(0.5%) on 3000A TiW	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	150C, 300 Hrs	77/0	-	-
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved
Manufacturability (Wafer Fab)	per mfg. Site specification	Approved	-	-
T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	-	-
ESD CDM	Per JEDEC	3/0	-	-
ESD HBM	Per JEDEC	3/0	-	-
Latch-up	per JESD78	6/0	-	-